**國立清華大學半導體研究學院 碩、博士班研究生【院辦畢業離校手續單】**

**□碩士□博士 元件部/設計部/材料部/製程部 學號： 姓名：**

* 同學請完成以下各欄位所列內容：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **論文線上建檔：**

**圖書館全文審查通過日期** | □圖書館**全文審核**通過 年 月 日□請同學檢附『論文電子檔審核通知單』之電子郵件紙本 |
| **2、學科實驗室** | □**指導教授同意學生可以離校** 【請指導教授『勾選』與『簽名』】 |
| **3、國科會計畫薪資** | □辦理離校手續時**仍**領有**國科會**計畫薪資，已向計畫業務承辦人員辦理薪資停發手續。□辦理離校手續時**未**領有國科會計畫薪資。 【請計畫承辦人員『蓋章』或『簽名』】□請同學檢附國科會薪資請領資料(如網頁公告附件10之範例) |
| **4、學院獎學金(院辦核實)** | □辦理離校手續時**仍**領有**學院獎學金**，已向業務承辦人員辦理停發手續。□辦理離校手續時**未**領有**學院獎學金**。 【請學院承辦人員『蓋章』或『簽名』】 |
| **5、外語能力檢定(請同學填寫)** | □TOEFL iBT 分 (測驗日期： 年 月)□TOEIC 分 (測驗日期： 年 月)□IELTS 分 (測驗日期： 年 月)□全民英檢 級 (測驗日期： 年 月)□日語檢定 級 (測驗日期： 年 月)□未參加(或通過)任何語文檢定 |
| **6、實習資訊(請同學填寫)** | □在學期間(含寒暑假)曾於 年 月至 年 月在 (企業/機構)實習□在學期間(含寒暑假)不曾參與實習 |
| **7、參與國內(外)研討會或論文****發表資訊(含期刊論文及研討會論文)(院辦核實)** | □在學期間參與國內(外)研討會或論文發表資訊，請填寫於google表單，連結：<https://forms.gle/mwJAy9adBq9ADEZZA>□在學期間未參與任何國內(外)研討會或論文發表 |
| **8、畢業動向(請同學填寫)** | □就業： 公司(職稱 )□研發替代役： 公司(職稱 )□一般替代役（警察役、消防役、社會役、環保役、醫療役、教育服務役、農業服務役及其他經行政院指定之役別。）□常備役(常備軍官役、預備軍官役、常備士官役、預備士官役、常備兵役、補充兵役)□升學： 學校 系所□其他(如待業、公職考試準備、回家幫忙等)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **9、應屆畢業生問卷(院辦核實)** | □已填寫**應屆畢業生問卷**(問卷請參考第二頁) |
| **10、國立清華大學學位論文符合****學術倫理聲明書(院辦核實)** | □已填寫**國立清華大學學位論文符合學術倫理聲明書** |
| □**已繳交電子檔論文定稿(院辦核實)**□**同意完成系所離校手續 【本表由院辦公室承辦人員簽章後留存系辦公室】** |

(續接第二頁：應屆畢業生問卷)

**國立清華大學半導體研究學院 碩、博士班畢業生問卷調查表**

本問卷調查表是教育部所需之教學佐證資料，希望了解同學在清華大學半導體研究學院碩、博士班學習期間，是否已學習並具備半導體相關系統專業領域相關之核心能力。

# 一、應屆畢業同學基本資料

□碩士班 / □博士班 部別：□元件部 / □設計部 / □材料部 / □製程部

入學學年度： 學號：

畢業學年度： 姓名：

#  二、本院碩、博士班教學成效意見調查(請勾選)

本院碩、博士班之教育目標：鑄造半導體科技所需要有的創新突破動力的領導人物。期望學院畢業生專、通、活三才具備。專才，在特定領域鑽研高深學問；半導體牽涉甚廣，故須具備廣大視野與半導體通識，與不同領域專才溝通合作，此為「通才」；專又廣的人才必須具備解決心問能力與開闢新領域的創意，故為「活才」。

為達成此教育目標，本院碩、博士班規劃並開授半導體專業領域相關課程，以建構培養學生具有問卷所列之十項核心能力。本問卷希望能了解你具有十項核心能力之信心度，以作為未來修正教育目標及改善課程與教學之參考。敬請依你的感受勾選下表問卷，謝謝。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本院碩博士班課程希望能培養學生具下列核心能力： | 此項核心能力重要 | 您已具備此項能力 |
| 非常同意(5分) | 同意(4分) | 普通(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意 (1分) | 非常同意(5分) | 同意(4分) | 普通(3分) | 不同意(2分) | 非常不同意(1分) |
| 1. 充實的半導體系統專業領域相關之科學及工程知識。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2. 具收集、分析及理解專業領域知識的能力。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3. 發掘專業領域問題並研究新的工程方法以獨立解決問題之能力。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4. 具創新設計、發明或改進半導體系統的能力。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5. 策劃與執行專題研究，以及團隊合作所需之組織、溝通及協調整合的能力。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6. 設計執行半導體系統研究所需實驗、分析數據及歸納結果的能力。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 7. 依學習或研究成果撰寫技術報告及論文之能力。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8. 掌握科技趨勢，並了解科技對人類、環境、社會及全球的影響。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9. 理解專業倫理及社會責任。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10.專業的外語能力及與國際專業領域社群互動的能力。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

# 三、畢業同學建言

#

＊問卷填寫完畢後，請於辦理離校手續時送回半導體研究學院辦公室，謝謝。